

证券代码:688729 证券简称:成都华微 公告编号:2024-045

成都华微电子科技股份有限公司关于自愿披露公司发布32位高速高可靠MCU芯片的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）研发了32位高速高可靠MCU“HWD32H743”于近日成功发布，现将相关情况公告如下：

一、新产品的基本情况

公司自主研发的HWD32H743芯片基于先进的32位精简指令集内核，运行频率高达400MHz，提供强大双精度浮点数字信号处理能力，拥有高达2MB的Flash和12KB的SRAM，这些卓越的性能指标使得HWD32H743芯片在工业控制、AIoT、嵌入式系统和智能设备等领域具有广泛的应用潜力。

在技术上，HWD32H743芯片不仅具备强大的数据处理能力，还集成了丰富的外设接口，包括GPIO、CAN、GPIO、UART、SPI、I2C、USB等，能够实现快速与其他设备进行通信和连接。此外，该芯片还支持多种扩展接口，进一步提升了其功能和应用范围。

二、对公司公告的影响

HWD32H743芯片的成功发布是公司持续技术创新和市场拓展的重要里程碑。未来，公司将继续加大在集成电路领域的研发投入，不断推出更多具有自主知识产权的新产品，以满足客户对高性能、高性价比产品的需求。

三、风险提示

本次公告所披露的32位高速高可靠MCU“HWD32H743”尚处于市场推广初期，尚未实现规模化销售，存在市场推广不及预期、客户开拓不及预期、客户验收失败等风险。公司将密切关注新产品对公司当前及未来经营业绩的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:600604 证券简称:哈投股份 公告编号:2024-040

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容提示：
●本次权益变动为持股5%以上非控股股东黑龙江省大正投资集团有限公司（以下简称“大正集团”）通过二级市场交易方式进行，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更；
●大正集团本次权益变动比例为2%。

一、本次权益变动的基本情况

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持股情况

信息披露义务人	名称	黑龙江大正投资集团有限公司
姓名	刘胜良	912001070283007A
任职	黑龙江哈尔滨市中北地区世茂大厦90010101号	

三、本次权益变动的目的

四、本次权益变动的后续安排

五、其他事项

六、备查文件

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2024年12月3日

股票代码:000629 股票简称:钼钛股份 公告编号:2024-47

攀钢集团钼钛资源股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钼钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘胜良先生的辞职申请，刘胜良先生因个人工作及履职精力等方面原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务，刘胜良先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

由于刘胜良先生的辞职将导致公司第九届董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司章程等有关规定，刘胜良先生的辞职报告将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，刘胜良先生将继续按照相关法律法规及公司章程规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，刘胜良先生未持有公司股份，不存在因履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘胜良先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

攀钢集团钼钛资源股份有限公司 董事会
2024年12月4日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-060

金陵华软科技股份有限公司关于控股股东变更工商登记信息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东舞钢钼钛集团有限公司（以下简称“舞钢科技”）通知，其住所由“北京市海淀区花园北路21号401-4-5”变更为“北京市海淀区花园北路2号二单元11”。目前舞钢科技已完成上述事项工商登记信息的变更手续，并取得北京市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体信息如下：

名称:舞钢钼钛集团有限公司
统一社会信用代码:91110000562072892C
法定代表人:霍耀
注册资本:20000万元
成立日期:2010年9月21日
住所:北京市海淀区花园北路21号二单元11
成立理由:2010年9月21日
住所:北京市海淀区花园北路21号二单元11
经营范围:技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;经济贸易咨询;企业管理;软件开发;开展经营业务;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人变更，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的股权结构及比例变化，对公司的经营活动不构成影响。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日

证券代码:688147 证券简称:先导智能 公告编号:2024-074

江苏微导纳米科技股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

回购方案实施日期	回购数量(股)	回购均价(元/股)	回购总金额(元)
2024年11月20日	4,000,000	8.00	32,000,000
2024年11月26日	4,000,000	8.00	32,000,000
2024年12月3日	4,000,000	8.00	32,000,000

二、回购股份的目的

三、回购股份的进展情况

截至2024年11月30日，公司尚未进行回购交易。

四、其他事项

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:600497 证券简称:德宏转债 公告编号:临2024-057

云南驰宏锌锗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购股份的基本情况

回购方案实施日期	回购数量(股)	回购均价(元/股)	回购总金额(元)
2024年10月24日	2,000,000	10.50	21,000,000
2024年11月15日	2,000,000	10.50	21,000,000
2024年11月28日	2,000,000	10.50	21,000,000

二、回购股份的进展情况

截至2024年11月30日，公司尚未进行回购交易。

三、其他事项

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:600130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:688130 证券简称:晶华股份 公告编号:2024-061

杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、会议地点

五、其他事项

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年12月4日